PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-036658

(43)Date of publication of application: 12.02.1993

(51)Int.Cl.

H01L 21/304 B08B 11/04 H01L 21/68 H05K 3/26

(21)Application number: 03-211460 (22)Date of filing:

30.07.1991

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

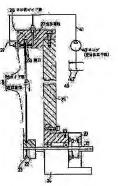
(72)Inventor: KIRIYAMA KENJI MASUOKA NOBORU

(54) SUBSTRATE CLEANING AND DRYING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the adhesion of particles to a substrate to be cleaned by eliminating the contact between the patterned surface of the substrate and a carrying mechanism and, at the same time, not providing any particle generating source in the space above the substrate in a substrate cleaning and drying device which cleans and dries square substrates. CONSTITUTION: A substrate carrying means 8 is constituted of a driving section 18 which supports the lower end section of a substrate 1 and a guide section 19 which guides the upper end section of the substrate 1 in a movable state, A U-shaped guide groove 26 which supports the end section of the substrate 1 in a noncontact state by means of a fluid is formed at least in the guide section 19 of the driving and guide sections 18 and 19 and, at the same time, a pump 40 is connected to a fluid passage 27 having an opening 27a in the groove 26. Therefore, the fluid is jetted upon the substrate 1 by

means of the pump 40 through the opening 27a of the



passage 27 and a fluid bearing mechanism is formed between the substrate 1 and groove 26. As a result, the substrate 1 is carried in a state where the substrate 1 does not come into contact with the guide section 19.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

315311(1)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平5-36658

(43)公開日 平成5年(1993)2月12日

(51)Int.Cl.* H 0 1 L 21/304 B 0 8 B 11/04 H 0 1 L 21/68	識別記号 341 C A	C 8831—4M 6704—3B	FI		技術表示體所			
H 0 5 K 3/26		6736—4E	審	查請求	未請求	請求項の数 2(全	6 頁	D

(21)出願番号

特願平3-211460

(22)出顧日

平成3年(1991)7月30日

(71)出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都新宿区西新宿 2 丁目 3 番 1 号 (72)発明者 桐山 建二

東京都新宿区

東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 東京 エレクトロン株式会社内

(72)発明者 増岡 昇

東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 東京 エレクトロン株式会社内

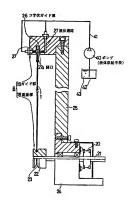
(74)代理人 弁理士 中本 菊彦

(54) 【発明の名称 】 基板洗浄・乾燥装置

(57)【要約】

【目的】方形状の基板を洗浄及び乾燥する基板洗浄乾燥 装置において、基板のパターン面と搬送機構との接触を なくし、かつ基板の上方部にはパーティクルの発生源を なくし、パーティクルの被洗浄基板への付着を防止す *

【構成】基数総差手段8を、基板1の下端部を支持する 駆動部18と、基板10上端部を移動可能に案内するガ ド部19とが成成さる、駆動118及びガイド部19 のうちの少なくともガイド部19に、基板1の端部を液 体によって非接触に支持するコ学状ガイド溝26を形成 すると共に、このコ学状ガイド溝26内に隣日27aす る液体通路27にポンプ40を接続する。これにより、ポンブ40によって流体が流体通路27にポンプ40によって流体が流体通路27にポンイト路26との 間に減体ペイリング機構が形成され、基板1はガイド部 19と呼続他の大機で機能で表しま板1はガイド部 19と呼続他の大機で機能を表れる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 方形状の基板を洗浄部及び乾燥部に搬送 して、上記洗浄部で基板の表裏面を洗浄した後、上配乾 燥部で基板の表裏面を乾燥する基板洗浄乾燥装置におい て、

上記基板の下端部を支持する駆動部と、基板の上端部を 移動可能に案内するガイド部とを具備し、

上記駆動部及びガイド部のうちの少なくともガイド部 に、上記基板の端部を流体によって非接触に支持するガ イド薄を形成すると共に、このガイド溝内に開口する被 10 体又は乾燥用気体の流体洒路に流体供給手段を接続して なることを特徴とする基板配件。乾燥装置

【請求項2】 方形状の基板を洗浄部及び乾燥部に搬送 して、上配洗浄部で基板の表裏面を洗浄した後、上配乾 樂部で基板の表裏面を乾燥する基板洗浄乾燥装置におい て、

上記基板の下端部を支持する駆動部と、基板の上端部を 移動可能に案内するガイド部とを具備し、

上配基動部及びガイド部のうちの少なくとも駆動部に、 上配基板の端節を流体によって非接触に支持するガイド 20 接を形成すると共に、このガイ諸内に関ローる後体又 は乾燥用気体の液体通路の端口を上記基板の搬送方向へ噴射 させることにより、上記基板を搬送取動させることを特 像とする基皮板斧・乾燥装匠

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は基板洗浄・乾燥装置に 関するもので、更に詳細には、例えば方形状の液晶ガラ ス基板、プリント基板あるいはその他の半導体基板等の 30 実裏面を洗浄すると共に、乾燥する基板洗浄・乾燥装置 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、脓晶がラス基板、ブリント基板 あるいは半導体基板等の方形状の基板の洗浄処理におい 焼砕効果を高めるため、基板を1枚ごた砕神部や 乾燥部に推送して洗浄・乾燥処理を行う枚楽観送方式が 採用されている。この場合、従来のこの種の充浄・乾燥 装置においては、基板を水平状態にして搬送ベルトや搬 送ローラにて基板を洗浄那及び乾燥部に搬送して、基板 40 の表裏面の洗浄・乾燥を行っている。

[0003]

【発明が解除しようとする問題】しかしながら、従来の この種の充浄・乾燥装置においては、水平方向に搬送さ れる基板の実真面に対向させて洗浄ノズルや破浄、ズル 等を配設するため、装置全体が大型となると共に、設備 費が潔むという問題があるだかりか、基板の表裏面の洗 冷・乾燥が不均一になり、洗浄効果等が不充分であると いう問題があった。

【0004】そこで、上記問題を解決する手段として、

図7に示すように、報直に立設された基板 a の下端部を 駆動ローラや駆動小ルト等の駆動機構 b にて支持すると 共に、基板 a 企動直列機 b 一分のガイドローラ c で挟 持して、基板 a 企動直列性 b 一分のガイドローラ c で挟 持して、基板 a 企動直状に横送し、搬送中の基板 a の表 延確を洗浄・乾燥する構造のものが考えられる。しか し、この構造のものにおいては、基板 a と駆動機構 b と の核熱部及び基板 a とガイドローラ c との接触部あるい はガイドローラ c の軸受部 d にパーティクルが発生する ことがある。このパーディクルのうち基板 a の下端部 パーティクルは洗浄や乾燥中に下部に落下させて除去す ることができるが、基板 a の上端部のパーティクルは基 核 a に付着してしまい、洗浄という目的が達成できない という問題がある。

【0005】この発明は上記事情に鑑みなされたもの で、基板の表集画を助ーに洗浄・乾燥させるように最直 転に徹遠し、かつかなくとも基板のバターン面と修送機 構との接触をなくし、かつかなくとも被洗浄基板に影響 を及ぼす基板の上方部にはパーティクルの発生液をなく してパーティクルの被洗浄基板。の付着を防止するよう にした基板洗浄・乾燥装置を提供することを目的とする ものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を連成するため に、この発明の基板成件・乾燥抜躍は、方形状の基板を た冷郁放り乾燥部に搬送して、上記洗浄部で基板の表裏 面を洗浄・乾燥装置を前提とし、上記基板の下端部を支 持する駆動部と、基板の上端部を移動可能に繋付するガイ イド部とを具備し、上記配動能及びガイド部のうちの少 なくともガイド部に、上記基板の端部を流体によって非 接触に支持するガイド溶を形成するとまに、このガイド 溝内に関ロする液体又は乾燥用気体の流体通路に流体供 捻手段を接続してなるものである。

【0007】この発明において、上記駆動部は基板の下 備節を支持すると共に、基板に搬送の駆動力を伝達する ものであれば、任意のものではく、例えば戦ニーラあ るいは搬送ベルト等にで形成することができる。この場 合、駆動能と基板との接触面積はなるべく小さい方がよ く、好ましくは基板の下端に駆動節を接触させる方がよ い。

[0008] 上記ガイド部は、基板の端部を流体によって非接触に支持するガイド操を有すると共に、このガイ ド溝内に開口する液体又は発展列気体の流体部に流体 供給手段を接続するものであれば基板の機造方向に沿設 される長手通しのものであっても差し支えないが、好ま しくは少なくとも基板の開端2箇所を同時に非接触に支 持する複数のガイドブロックを基板機造方向に関隔をお いて配設する方がよい。また、上記流体連絡の開口は対 イド溝の同側に設けられるものであれば開口の向きは任 意であってもよいが、好ましくは基板に対して直角ある 20

いは基板の搬送方向に向って傾斜する角度をもたせる方 がよい。

【0009】また、上記ガイド環及び途体部階は少なくともガイド部に設けられていれば駆動部は上述したように搬送ローラ、搬送ベルト等にで形成してもよいが、少なくとも駆動部のガイド溝の流体通路の開口を基板の搬送方向に向けて候斜させる構造とすることにより、駆動配することができる。この場合、ガイド溝は基板の搬送方向に沿限される長手通しに形成する必要がある。 [0010]

【作用】上記のように構成されるこの発明の基板洗浄・ 乾燥装置によれば、基板の下端部を支持する駆動部と基 板の上端部を移動可能に案内するガイド部のうちの少な くともガイド前に、基板の端部を流体によって非接触に 支持するガイド溝を形成すると共に、このガイド溝内に 開口する液体又は乾燥用気体の液体通路に液体供給手段 を接続することにより、基板を垂直状態に維持して洗浄 都及び整燥部に換送し、洗冷及び乾燥処理するとかで

[0011] また、ガイド部にて案内される基板には弦 体供給手段から供給される液体又は乾燥用気体が噴射さ れることにより、基板とガイド溝との間に流体板が形成 され、この液体膜による液体ペアリング機構によって基 板は円滑に移動薬内され、しかも、基板とガイド部とは 非接触なため、パーティクルの発生がない。 パーティクルの発生がない。

[0012]

きる。

【実施例】以下にこの発明の実施例を図面に基いて詳細 に説明する。

【0013】図1はこの発明の基板洗浄・乾燥装置の概 30 略斜視図、図2は駆動部とガイド部の断面図、図3は駆動部とガイド部の要部斜視図が示されている。

【0014】この発明の基板洗浄・乾燥素置は、洗浄を れる複数枚の基板1を重直状に吹寄する基板供給部2 、基板1の表展面に向って関ロする洗浄ノズル3を有 する基板洗浄部4と、基板1の表展面に向って関ロする 乾燥ノズル5を有する基板乾燥部6と、洗浄・乾燥され た基板1を重直状に収容する基板取出部7と、基板供給 部2から基板洗浄部4及び基板乾燥部6を貫通して基板 取出部71配股される基板敷送半段8とで構成されてい 6。

【0015】基板供給節2は、基板供給節2の架合9上 に基板1の搬送方向と直交する方向に移動自在に軟置さ れるスライド節10と、このスライド節10上に設置さ れて複数枚の基板1を間隔をおいて重直状に収納するカ セット11と、カセット11の側方に配置されてカセッ ト11内の基板1を1枚で一基板搬送手段8 側に送り出 押担出機構12とで構成される基板供給機構を具備 している。この場合、カセット11万形件状に形成さ 1、その上下対向面には基板1を提動自在にかつ垂直状 大板1、その上下対向面には基板1を提動自在にかつ垂直状 態に保持する案内溝(図示せず)が設けられて、押し出 し機構12の動作によって押圧された基板1が案内溝に 沿って移動して基板搬送手段8側に送り出されるように なっている。

【0016】基板洗浄部4は、基板1の洗浄を効率良く 行うために複数の洗浄部にて形成されており、各洗浄ノ ズル3は各洗浄部4の洗浄目的に応じた構造となってい るが、基本的には垂直方向に沿うスリット状の噴口を有 するノズルが使用されている。

10 【0017】基板軟操部6は、基板軟燥部6の中央において、基板1に関して対称な位置に最直状に配設される スリット状の噴口を有する一分の軟燥ノズルであるエア ーナイフ型ノズル6を具備している。

【0018】また、基板販出部では、基板供給部と同様 に、報告9上に基板1の搬送方向と直交する方向に移動 自在に載置されるスライド部10と、このスライド部1 0上に設置されて複数枚の基板1を開稿をおいて重度状 に収納するカセット11と、カセット11の例で配配 されて基板搬送手段8により搬送された基板1をカセット ト11内に押出す押し出し機構(図示せず)とで構成さ れている。

【0019】一方、基板搬送手段8は、基板1の搬送方 向に沿って運宜開降をおいて配設されており、図1に示 すように、基板1を乗直放けに支持すべく基板1の下端部 に接触する駆動部18と、基板1の上端部を移動可能に 案内するガイド部19とで構成されている。

【0020】この場合、駆動部18は図示しない駆動キータからの駆動を伝達して回転する伝達プーり20を有する回転者21に数素される機造モーラ22にび張改されている。なお、この搬送ローラ22には基板1の下端面を支持するび形法23が設けられており、基板11との接触面積を可及的に小さくしている。

【0021】また、ガイド部19は、搬送ローラ22を 回転自在に取付けた駆動プロック24に垂直板25を介 して連結されるガイドプロックにて形成されている。こ のガイド部19は、基板1の上端部を流体によって非接 触支持する例えばコ字状のガイド溝26と、このコ字状 ガイド溝26の対向する側壁に開口する流体通路27と を有しており、図面に示す基板洗浄部4においては、流 体通路27は供給管路41を介して液体供給源であるポ ンプ40と接続されており、液体タンク42内の液体4 3がポンプ40によって圧送されて流体通路27の開口 27aから基板1に向って噴射することによりいわゆる 流体ベアリング機構が形成されるようになっている。な おこの場合、図4に示すように、流体通路27の開口2 7 a を基板 1 の搬送方向に向って傾斜させることによ り、流体通路27から噴射される液体43に基板1の搬 送方向の分力が生じ、この搬送方向分力によって基板の 搬送をより一層円滑に行うことができる。なお、基板乾 燥部6においては、液体に変えて乾燥用清浄空気又はN

2 ガスを使用することにより、同様に基板1とコ字状ガイド溝26との間に流体膜による流体ペアリング機構を形成することができる。

【0022】上記のように基施療送手段8を形成することにより、基板1の下端部は駆動師18の機送由一ラ2とによって支持され、基板10上端部はガイド部19に噴射される液体又は乾燥用気体によって支持されるので、基板11年重状態に維持される。そして、この状態で、基板11年重射係18の験送ローラ22の回転によって搬送される。なおこの場合、搬送ローラ22に変えて搬送ベルトを使用することもできる。

【0023】上記のように構成される各基板洗浄節4、基板乾燥節6は、駆動販や記憶子級を収納する機械室2 8の上部に股付られた室29円洗浄イブル3又はエアーナイフ型/ズル5を配設すると共に、基板搬送手段8 の2組の駆動節18とガイド節19とを配設してなる (図1参照)。なお、室29条間皮するを搬送方向の 側壁30には、基板1が通過する基板搬送用間口31が 設けられている。また、室29の床部すなわち機械室2 8の天井部には図示しないサイエロ又は外仮口設定けられており、基板洗浄部4で使用された液体や基板軟締部6 で除去された水等が外部に排出されるようになっている。

【0024】次に、この発明の基板洗浄・乾燥装置の作 動馬様について説明する。

【0025】基板供給部2にセットされたカセット11をスライド部10によって移動して、カセット11所の設部側の基板1を押し出し機構12の前方に位置させた後、押し出し機構12を押出し動作させると、基板1は3を板後送手段8の基板供給部側の駆動部18とガイド部19に押し出される。

【0026】押出された基板1は駆動部18の搬送ロー ラ22によって下端部が対対されると共に、ガイド部1 9のコ宇状ガイド港26内に噴射される液体の腰によっ て上端部が支持され、そして、撤送ローラ22の回転に よって第1洗浄部4aに搬送され、洗浄が行われる。

【0027】第1洗浄部4aで洗冷された基板1は同様 に第2洗浄部4b、第3洗浄部及び第4洗浄部で洗冷さ れた後、基板乾燥部6に搬送され、基板乾燥部6におい 40 て、エアーナイフ型ノズル5から搬送中の基板1の表裏 面に噴射される乾燥用気体によって乾燥される。

【0028】基板乾燥節6で乾燥された基板1は基板取 出部7に移動されて、押し出し機構12の押出し動作に よってカセット11内に収容されて、1枚の基板1の洗 冷・乾燥が完了する。

【0029】上記のように基板供給部2のカセット11 内の基板1は、順次押し出し機構12によって1枚ずつ 基板搬送手段8に搬送された後、駆動部18とガイド部 19によって垂直に維持された状態で連続的に基板10 50 表裏面の洗浄及び乾燥処理が行われる。

【0030】 たお、上記実施例では基弦療送半段8の服動部18が搬送ローラ22又は微送ベルトで構成される 場合について説明したが、図5及び図6に示すように、 駆動部18を基板10下端前を非接触に包囲する例えば コ字状のガイド溝51を有する長手通し状の駆動プロッ ク50に下形成すると共に、コ字状ガイド港51の両側 壁に関口する液体通路52の関口52aを基低1の搬送 方向に向って傾斜させ、そして、流体通路52に供給管 路41を介して液体映給半展例えばボンブ40を接続

日本1 とかして保存中部市本研究(AIA・アンイなど変換 し、被体タン4 2内の液体49 を流体通路52から基 板1に向けて噴射させるようにしてもよい、なおこの場 合、ガイド部19も同様に図4に示す構造とする方が望 ましい。このように形成することにより、基板1の下端 部と駆動館18との放焼を更に少なくして、基板1への バーティクルの付着を皆無にすることができる。

【0031】また、上記構造の駆動プロック50と搬送ローラ22とを組合せて駆動部18を形成することも可能である。

[0032]

【発明の効果】以上に説明したように、この発明の基板 洗浄・乾燥装置によれば、上記のように構成されている ので、以下のような効果が得られる。

【0033】1) 基板を垂直状態で搬送することができると共に、基板上端部と基板敷送手段とを非接触で搬送 することができるので、基板へのパーティクルの付着が なく、基板洗浄部及び基板乾燥部に効率良く搬送するこ とができる。

【0034】2)搬送中の基板の表裏面に液体や乾燥用 気体を均一に噴射することができるので、洗浄及び乾燥 むらがなく、洗浄効果及び乾燥効果の向上を図ることが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の基板洗浄・乾燥装置の一例を示す概 略斜視図である。

【図2】この発明における駆動部及びガイド部を示す断 面図である。

【図3】駆動部とガイド部を示す要部斜視図である。

【図4】この発明におけるガイド部の別の実施例を示す 一部断面平面図である。

【図5】この発明における駆動部の別の実施例を示す断 面図である。

【図 6】図 5 の V I - V I 線に沿う断面図である。 【図 7】従来の基板搬送手段の一例を示す断面図であ

【符号の説明】

1 基板

4 基板洗浄部

6 基板乾燥部

8 基板搬送手段

- 18 駆動部
- コ字状ガイド溝 27 流体通路
- 27a 開口

- 40 ポンプ (流体供給手段)
- コ字状ガイド溝

